

# 株式会社東京精密 2021年度(2022年3月期)決算 2022~2024年度中期経営計画説明会

2022年5月10日

代表取締役会長 CEO	吉田 均
代表取締役社長 COO	木村 龍一
代表取締役副社長CFO	川村 浩一
取締役 計測社カンパニー長	塚田 修一

## ◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報, ならびに口頭で提供される情報は, 現時点で入手可能な情報をもとに, 当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは, 市況, 競争状況, 半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って, 今後の当社の実際の業績が, 本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

## ◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き, 半導体製造装置セグメントを「半導体」, 精密計測機器セグメントを「計測」, また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は, 注記がある場合を除き, 億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為, 内訳の計が, 合計と一致しない場合があります。

## ◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は, 監査法人による監査の対象外です。

## 次第

### I. 2021年度業績説明, 2022年度業績予想

～質疑応答～

### II. 2022-2024年度 中期経営計画

～質疑応答～

# 2021年度 連結業績



通期業績(億円)	2020年度		2021年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	1,171		1,911		+63%
売上高	971		1,333	+53	+37%
営業利益 (営業利益率)	156 (16%)		286 (21%)	+21	+84%
経常利益	159		294	+29	+85%
当期純利益	122		214	+21	+76%
1株配当	104円		185円	+17円	+81円

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	187	210	351	423	417	468	567	459	-19%	+8%
売上高	211	240	216	304	289	325	320	398	+25%	+31%
営業利益 (営業利益率)	32 (15%)	31 (13%)	30 (14%)	62 (20%)	60 (21%)	69 (21%)	63 (20%)	93 (23%)	+47%	+49%
経常利益	33	31	29	65	60	70	66	98	+49%	+51%
当期純利益	25	22	23	52	44	53	48	71	+48%	+35%

➤ 前期比 增收増益 (中期目標達成) 堅調な半導体製造装置が売上増に寄与

# 半導体製造装置セグメント



セグメント業績 (通期：億円)	2020年度		2021年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	932		1,574		+69%
売上高	717		1,034	+34	+44%
営業利益 (営業利益率)	136 (19%)		249 (24%)		+84%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	129	159	287	357	339	386	467	383	-18%	+7%
売上高	154	180	151	232	228	249	247	310	+25%	+33%
営業利益 (営業利益率)	28 (18%)	29 (16%)	25 (17%)	54 (23%)	53 (23%)	60 (24%)	53 (22%)	83 (27%)	+55%	+54%

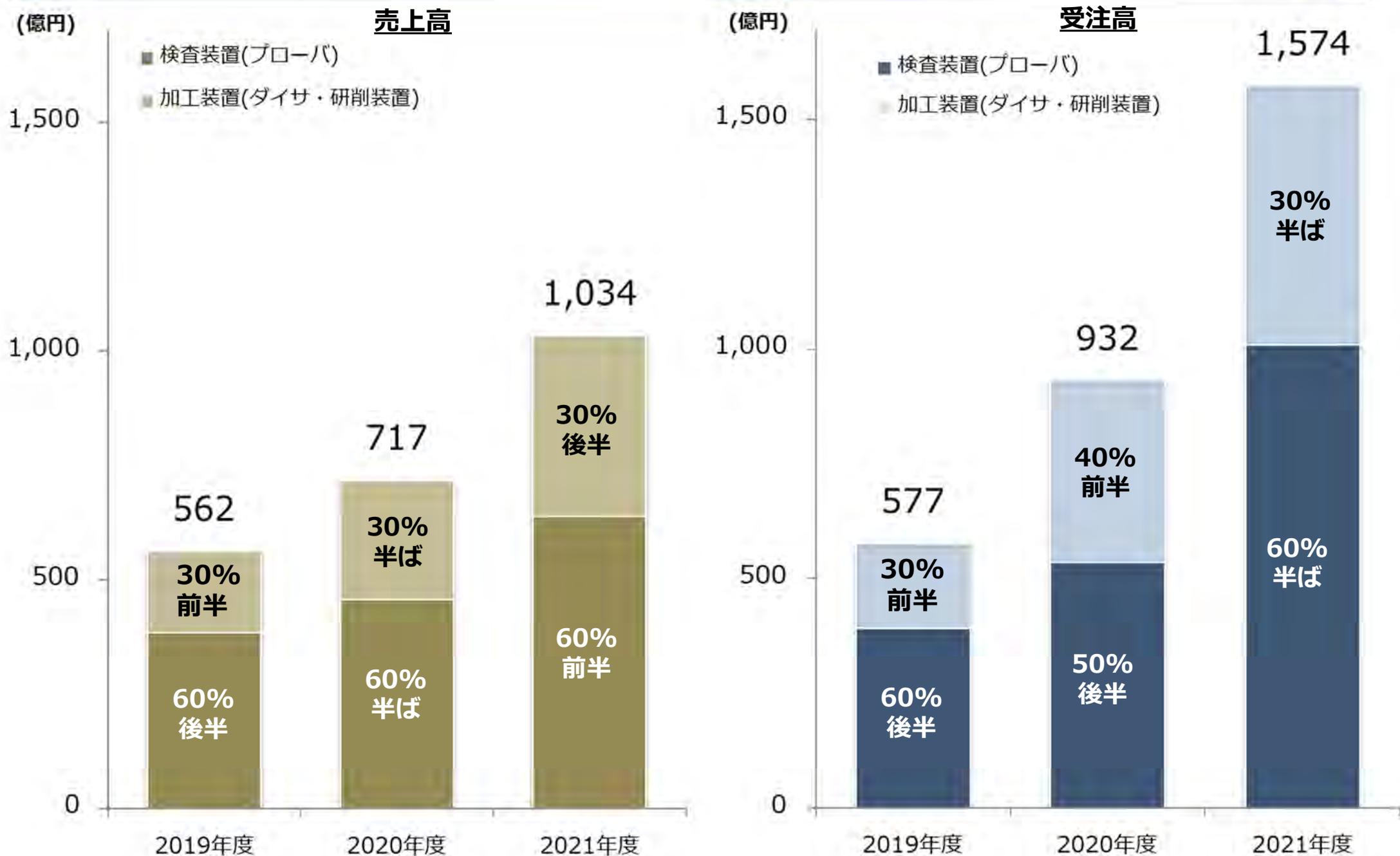
- 通期売上高は公表予想対比上振れ、受注高・売上高・営業利益は既往ピークを更新
- 営業利益率は年度を通じて20%超を維持
- 第4四半期 売上高・営業利益・営業利益率ともに過去最高

# 半導体 - 四半期業績推移



- 部材逼迫・物流停滞の状況下、生産は拡大
- 第4四半期 受注高は前四半期比減少も、ロジック・電子部品を中心に高水準を維持

# 半導体 - 製品別動向



セグメント業績 (通期：億円)	2020年度		2021年度		
	通期		通期	予想対比	前期比
受注高	239		337		+41%
売上高	254		299	+19	+18%
営業利益 (営業利益率)	20 (8%)		37 (12%)		+85%

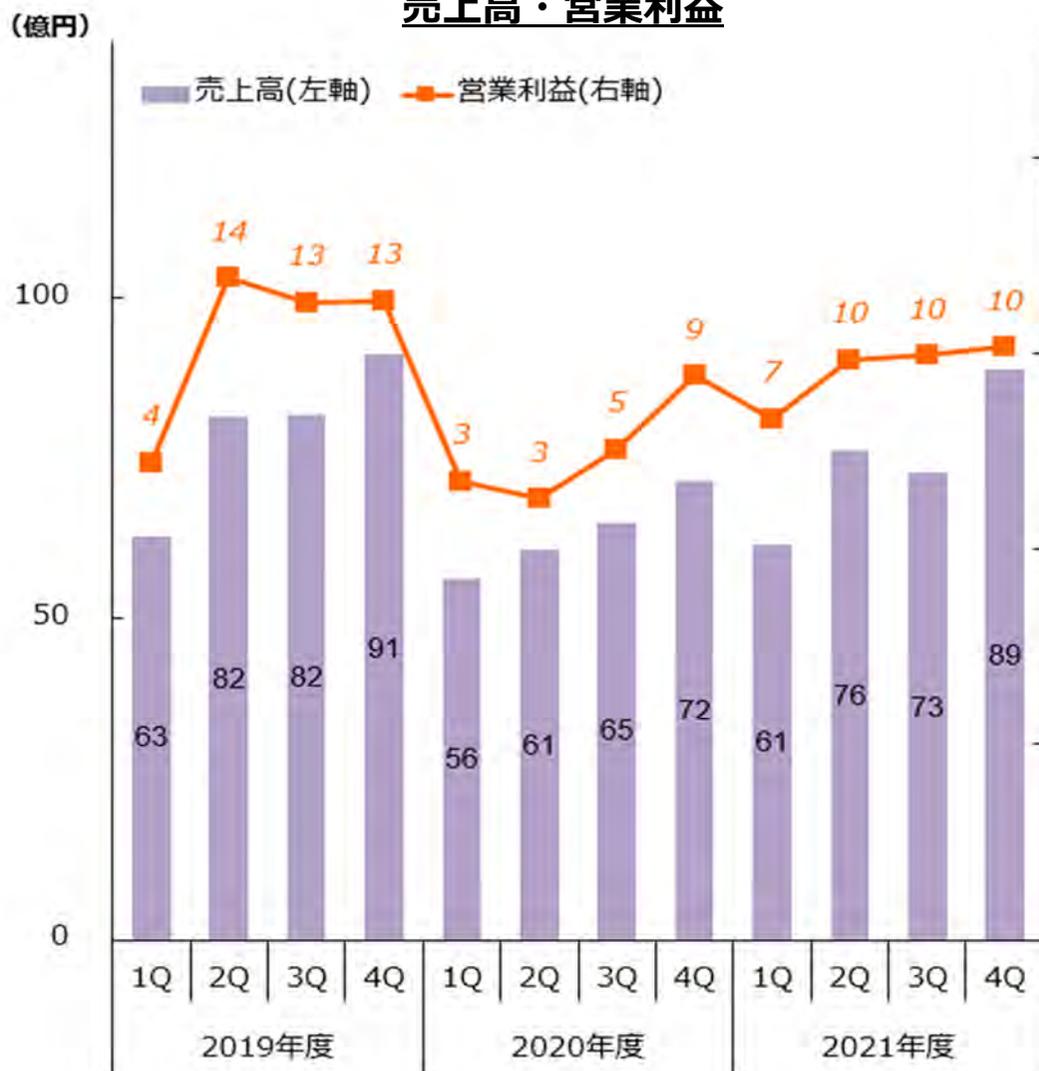
四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	58	50	64	67	79	82	101	76	-25%	+13%
売上高	56	61	65	72	61	76	73	89	+22%	+24%
営業利益 (営業利益率)	3 (6%)	3 (4%)	5 (8%)	9 (12%)	7 (11%)	10 (13%)	10 (14%)	10 (12%)	+4%	+17%

- 通期売上高は公表予想対比上振れ、増収増益の着地
- 四半期受注高は、前年度第2四半期を底とした回復が続いた
- 自動車向け需要回復は緩やかながら、半導体を始めとした機械需要を取り込み

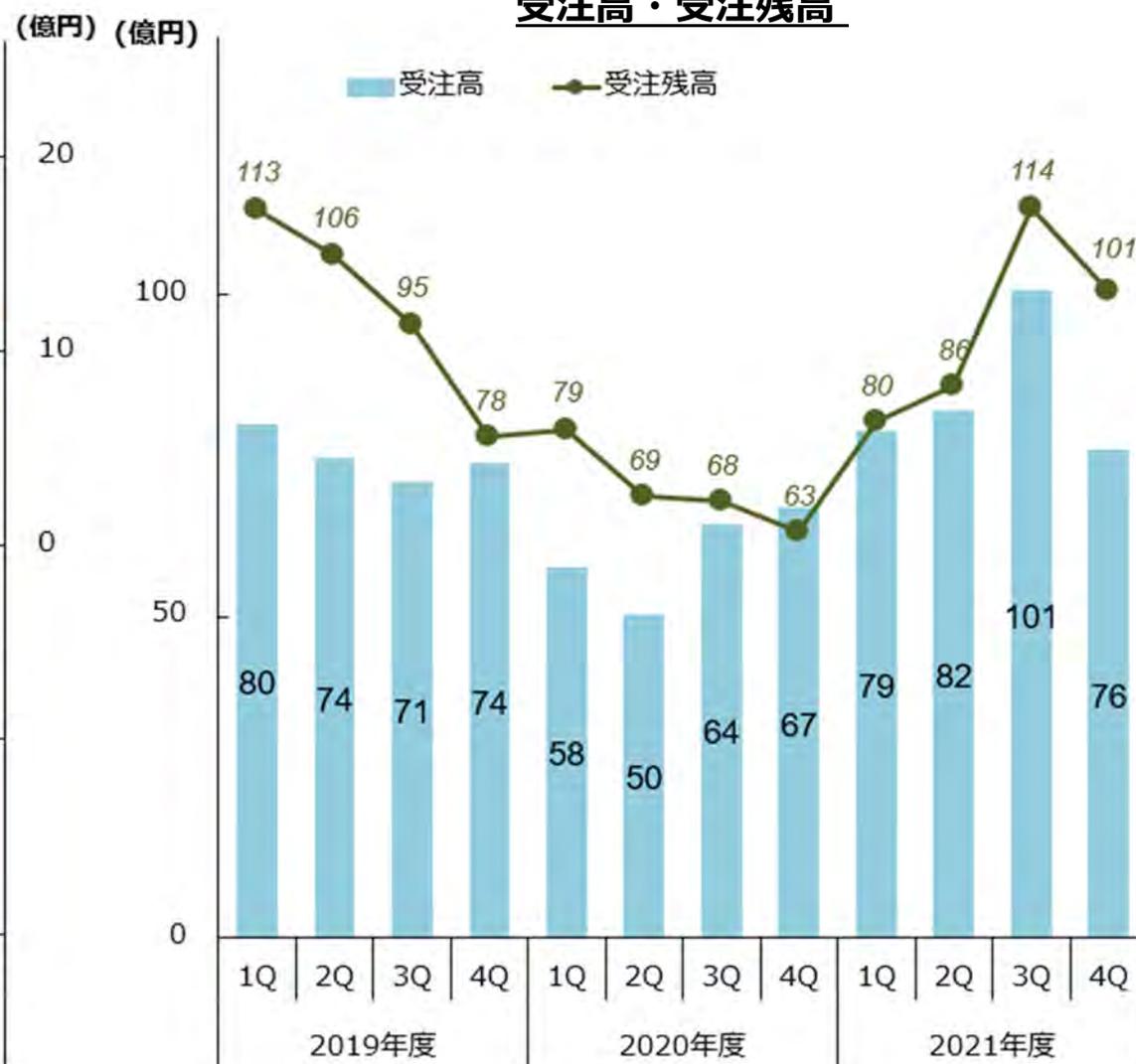
# 計測 - 四半期業績推移



## 売上高・営業利益

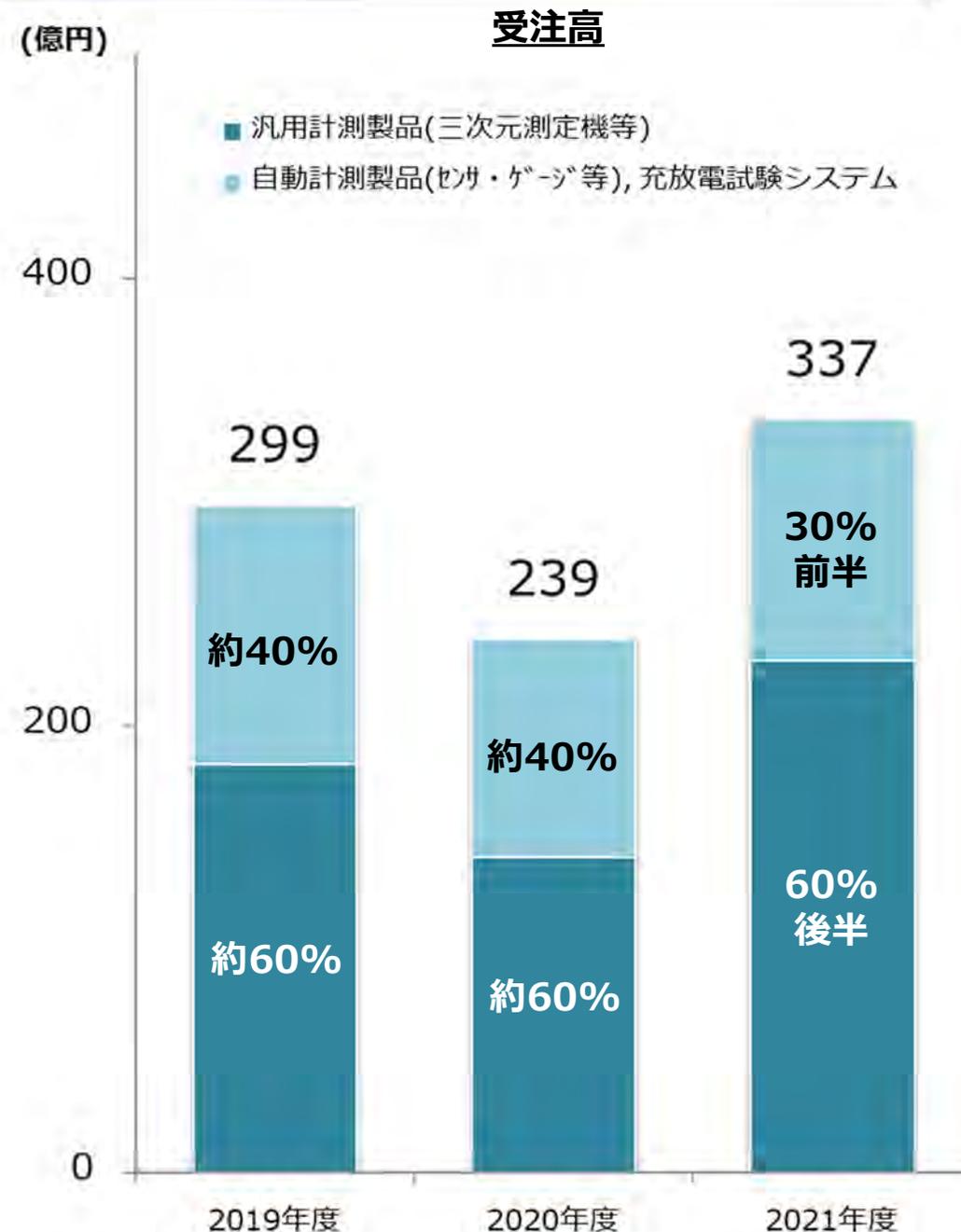
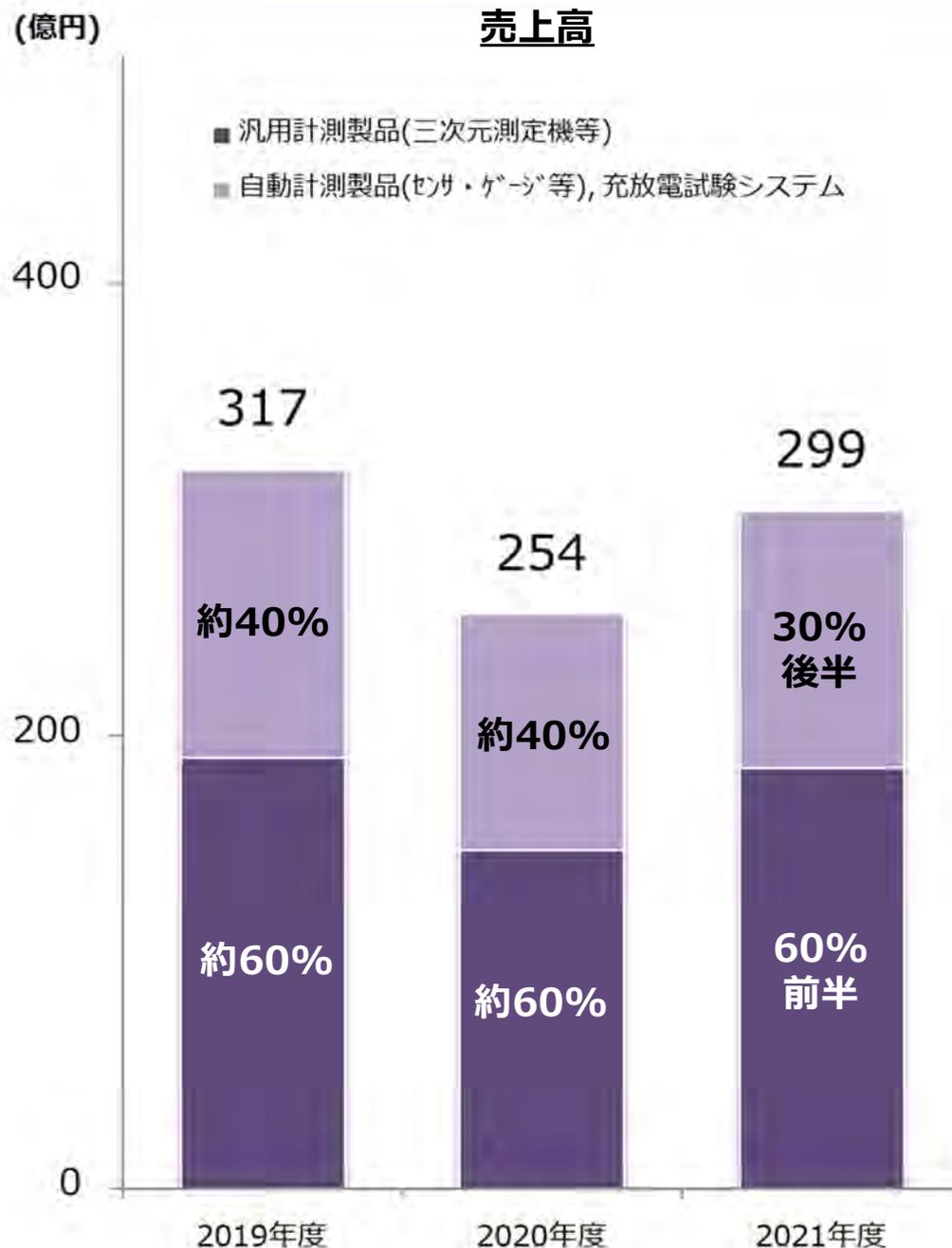


## 受注高・受注残高



- 売上高は回復基調
- 第4四半期受注高は 前四半期比からの反動もあり減少 全体では回復の流れ

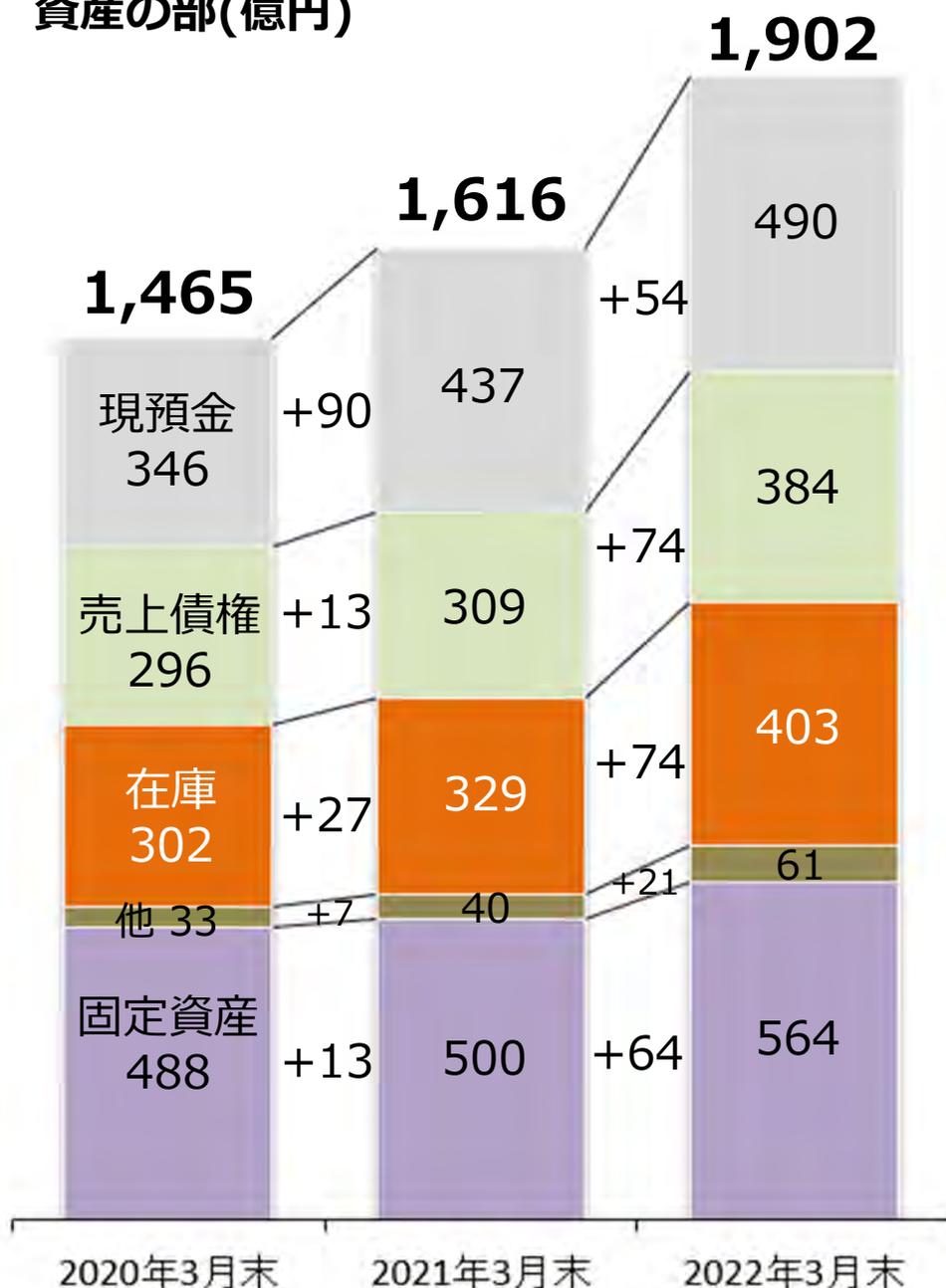
# 計測 - 製品別動向



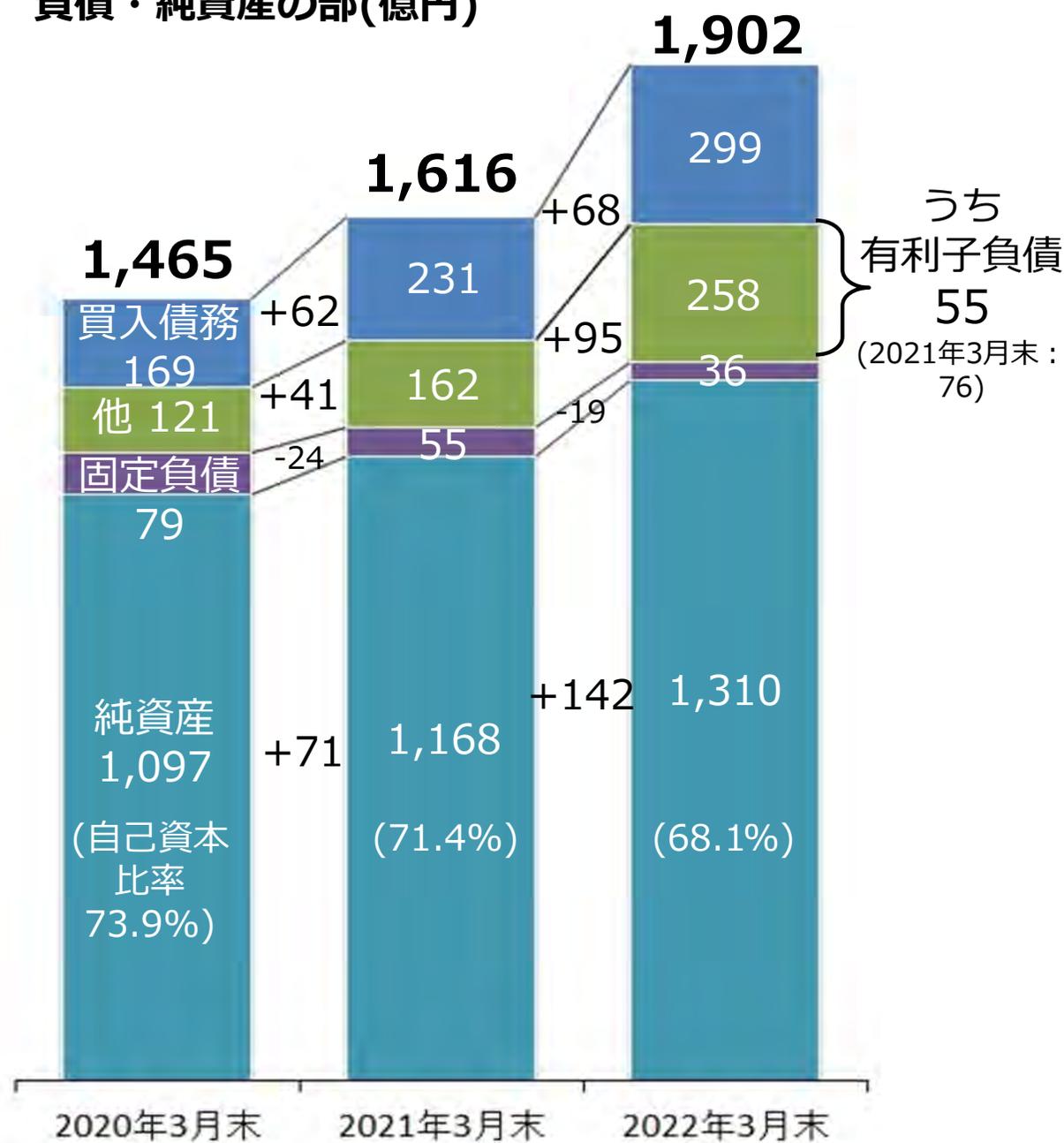
# 貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



2020年3月末

2021年3月末

2022年3月末

2020年3月末

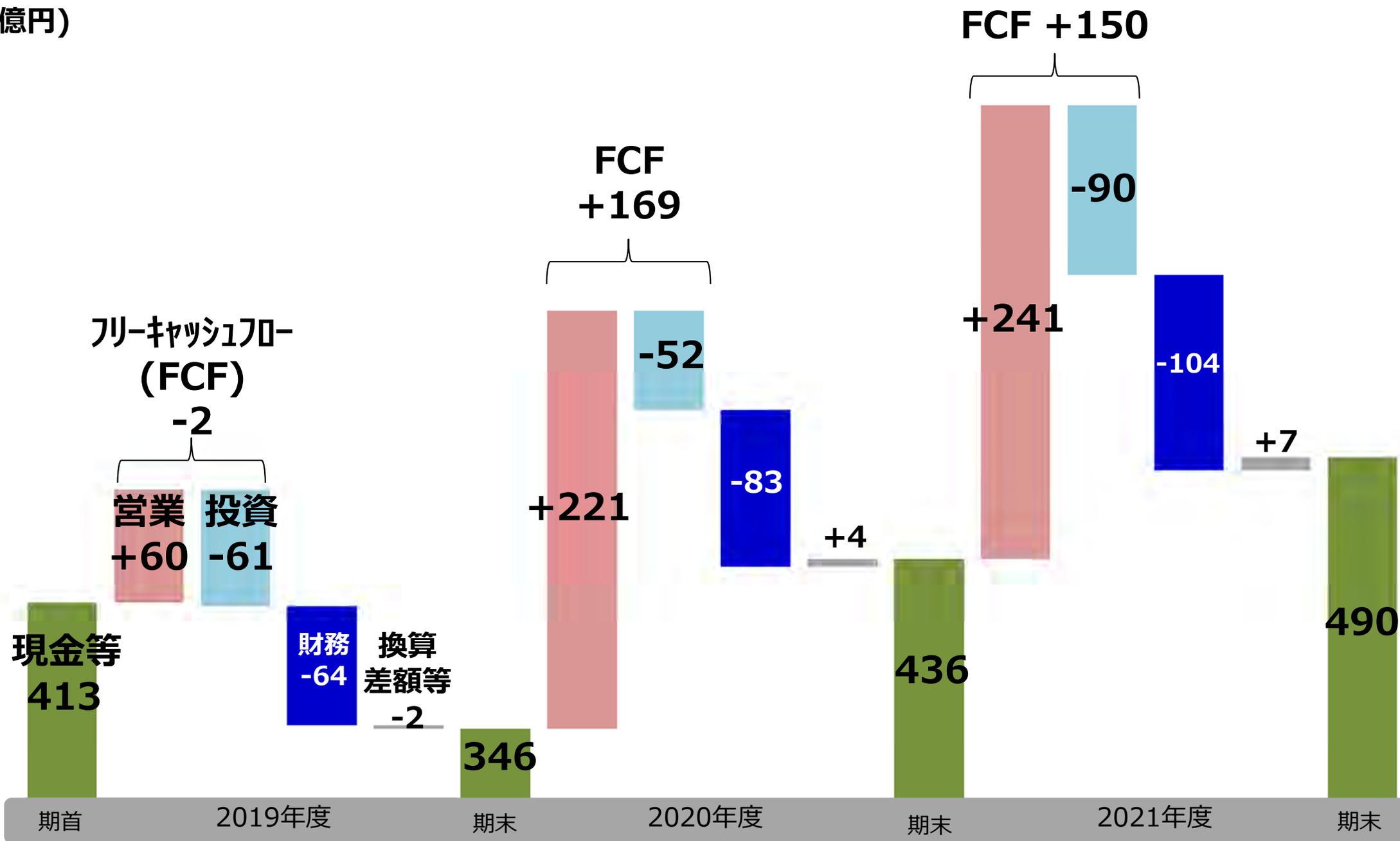
2021年3月末

2022年3月末

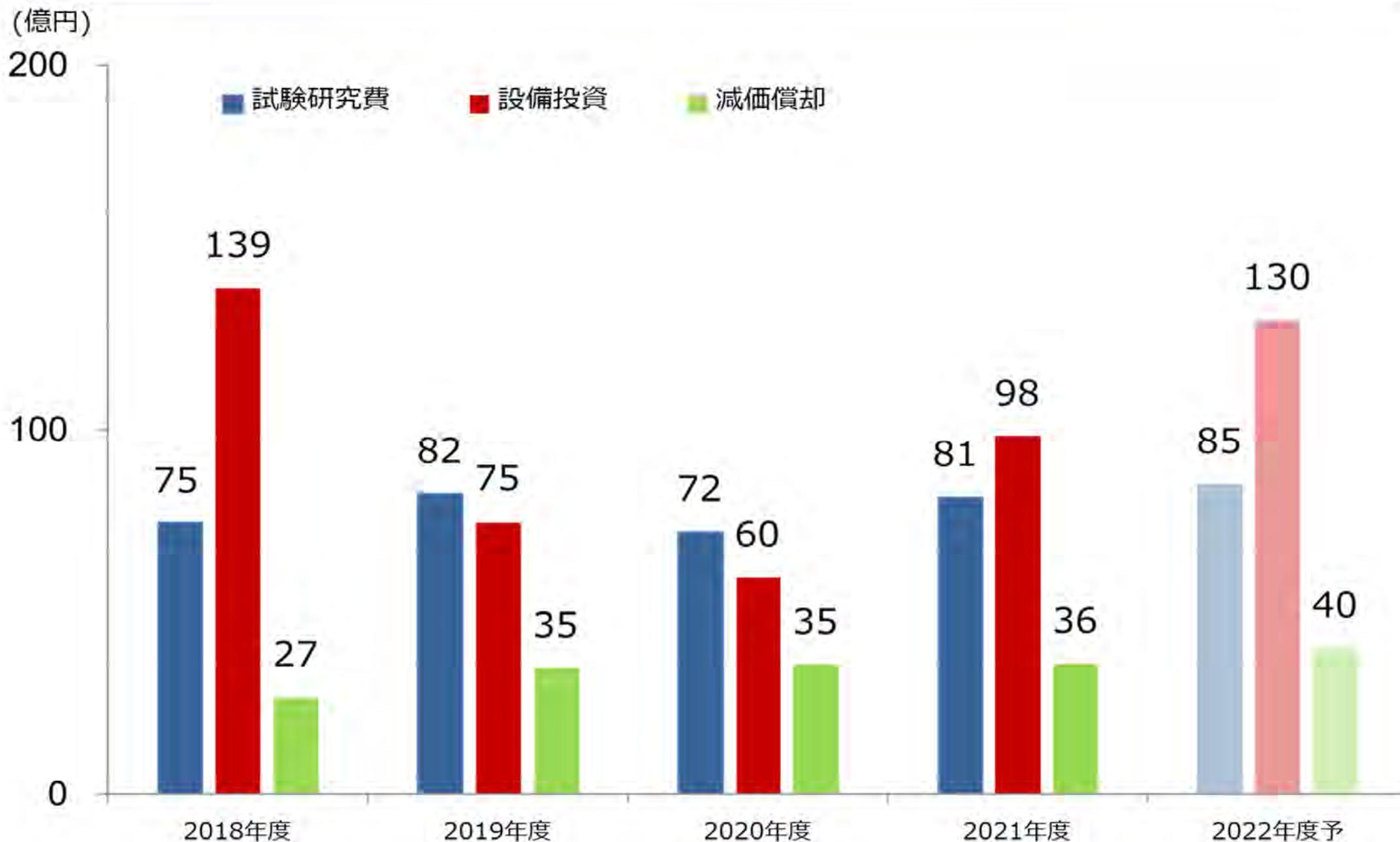
# キャッシュフロー(CF)



(億円)



# 試験研究費, 設備投資, 減価償却 (実績・計画)



## 全体

- 年度を通じて高水準の生産を維持
- 部材不足、物流停滞、地政学リスク、コロナ動向を注視

## 半導体

- 受注は短期的調整があるとの想定を維持
- 生産拡張対応、研究開発に加えアプリケーションセンタ強化活動に取り組む

## 計測

- 自動車関連の回復は引き続き緩やか
- 半導体、NEV、自動化分野への拡販を推進

# 2022年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2021年度			2022年度予			
	上期	下期	通期	上期予	下期予	通期予	前期比
売上高	615	718	1,333	745	755	1,500	+13%
営業利益 (営業利益率)	129 (21%)	156 (22%)	286 (21%)	153 (21%)	158 (21%)	311 (21%)	+9%
経常利益	130	164	294	153	158	311	+6%
当期純利益	96	118	214	108	112	220	+3%
1株配当			185円			218円	+33円

## セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	725	850	1,574				
	売上高	477	557	1,034	585	585	1,170	+13%
(計測)	受注高	160	177	337				
	売上高	138	161	299	160	170	330	+10%

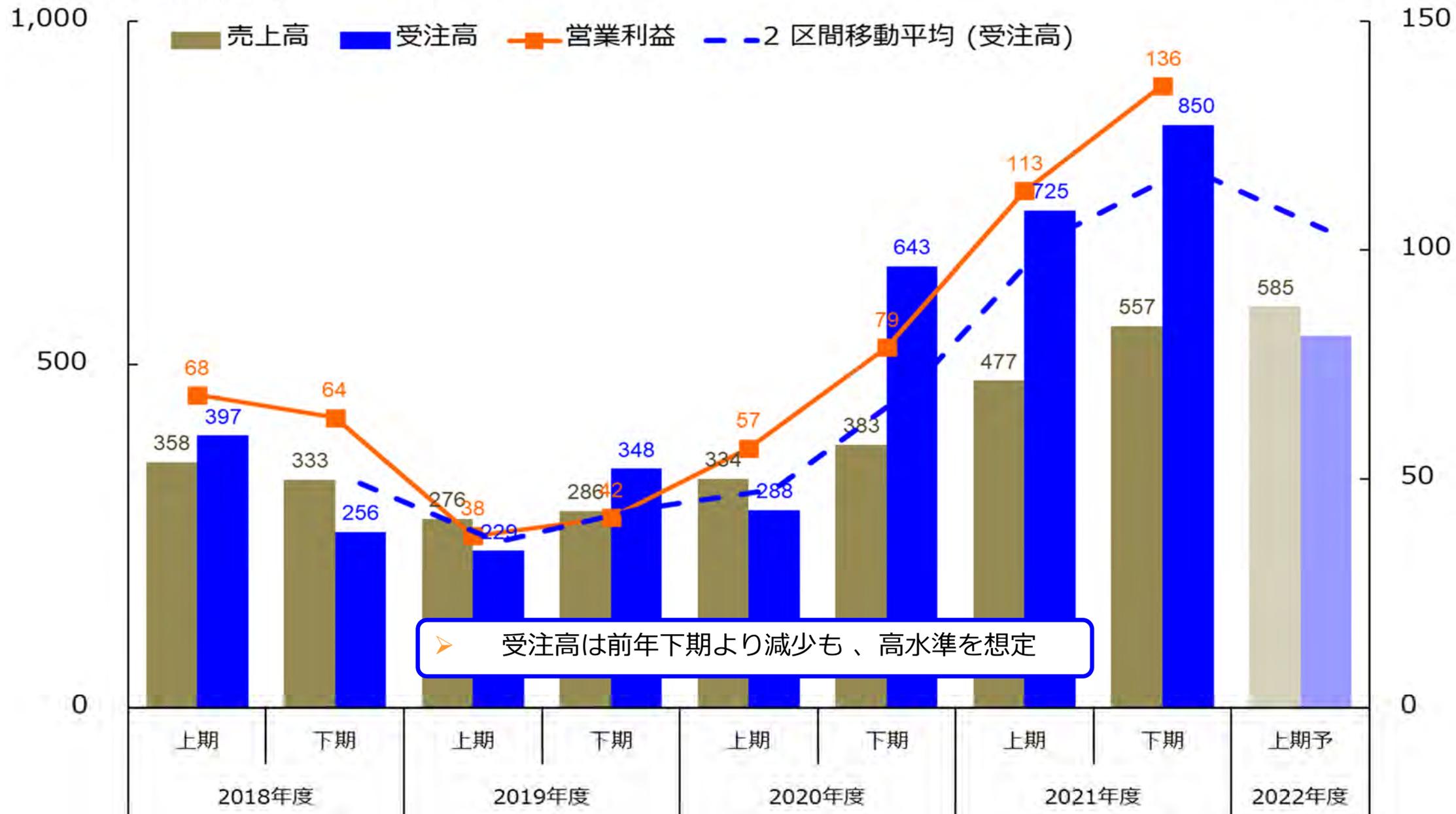
- 半導体・計測共に増収増益、また増配を予想
- 部材価格高騰、中国ロックダウン影響などを予想に反映

# 半導体 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)

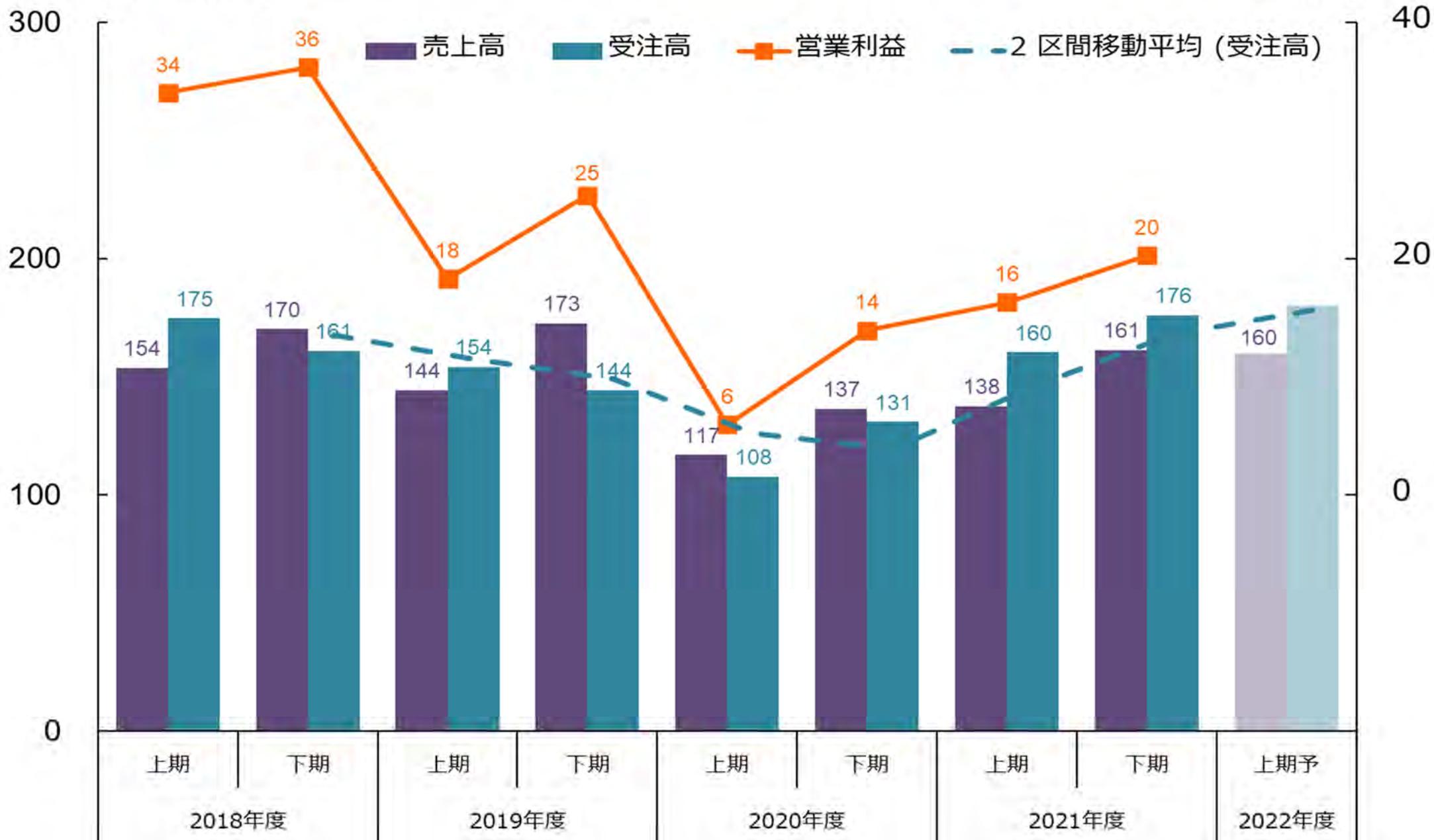


# 計測 - 売上・受注高 見込



売上高・受注高(億円)

営業利益(億円)



## 次第

I. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想

～質疑応答～

II. 2022-2024年度 中期経営計画

～質疑応答～

## 次第

I. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想

～質疑応答～

II. 2022-2024年度 中期経営計画

～質疑応答～

**長期指標：ROE10%以上**

**中期目標：営業利益220億円**  
(2021年度迄に)



両輪にて達成

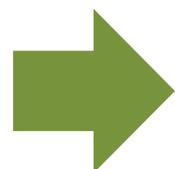


**売上拡大**  
(1,100億円を目指す)

**利益率向上**  
(営業利益率20%以上を目指す)

**2021年度 ROE 17.5%**

**売上高 1,333億円 営業利益 286億円 (利益率 21.4%)**



## 半導体：新たな成長ステージ

- ネットワーク関連：メモリ、電子部品、センサ
- 車載関連：センサ、パワー、SiC基板
- 中国需要：投資本格化、生産拠点建設ラッシュ（～2019年）

- 
- ネットワーク関連：5Gを基幹技術として急速に成長
  - 車載関連：クルマの自動化・電装化・EV化で安定成長
  - 中国需要：国策もあり想定以上の拡大
  - 巣ごもり需要・リモートワーク拡大が、デバイス需要を押し上げ

## 計測：持続的な成長の継続

- 自動車：プラットフォーム革新、内燃機関 開発継続
- 工作機械：需要拡大に伴うゲージ需要，IoT
- 航空機：特に新興国の中型ジェット機 需要

- 
- 自動車：概ね想定通りなるも、NEVへの移行が急速に進む
  - 新型コロナ感染症拡大は2020年度以降の環境を大きく変えた  
特に 工作機械・航空機需要は大きく減少
  - ものづくり自動化に向けた、関連ビジネスが想定以上に伸張

# 2018-2021年度 中期目標 総括 全社戦略、主な取り組み



	戦略	主な取り組み
技術面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品競争力強化</li> <li>● 対象市場拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次世代に向けた<b>新製品展開</b></li> <li>● 計測製品での<b>事業提携</b></li> <li>● <b>アプリケーションセンタ</b>新設・拡張</li> </ul>
生産面	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 生産能力拡充</li> <li>● 効率改善（<b>自動化,省人化</b>）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>キャパシティ</b>拡張 計測：新棟（MI棟）稼働 半導体：新工場（飯能工場）</li> <li>● 計測工場の<b>半導体生産への活用</b></li> </ul>
利益率改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 情報共有化促進</li> <li>● サービス,消耗品売上の拡充</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ERP導入</b>による業務効率化</li> </ul>
ESG	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>ESG活動</b>を推進、企業価値向上を図る</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>サステナビリティ委員会</b> 設立</li> <li>● <b>CO2排出量の削減</b></li> </ul>

## キャパシティ拡充(半導体)

- 美山工場：フル稼働継続
- 飯能工場：建設中
- 土浦MI棟：半導体事業にも活用



## キャパシティ拡充 (計測：土浦MI棟)

- 2020年5月稼働開始
- 半導体製造装置生産にも活用



MI: Monozukuri Innovation

## 効率化

- ERPによる業務改善・効率化取り組み継続

## アプリ対応強化 (台湾新アプリセンター設立)

- 2021年3月稼働開始



## アプリ対応強化 (大阪計測センターリニューアル)

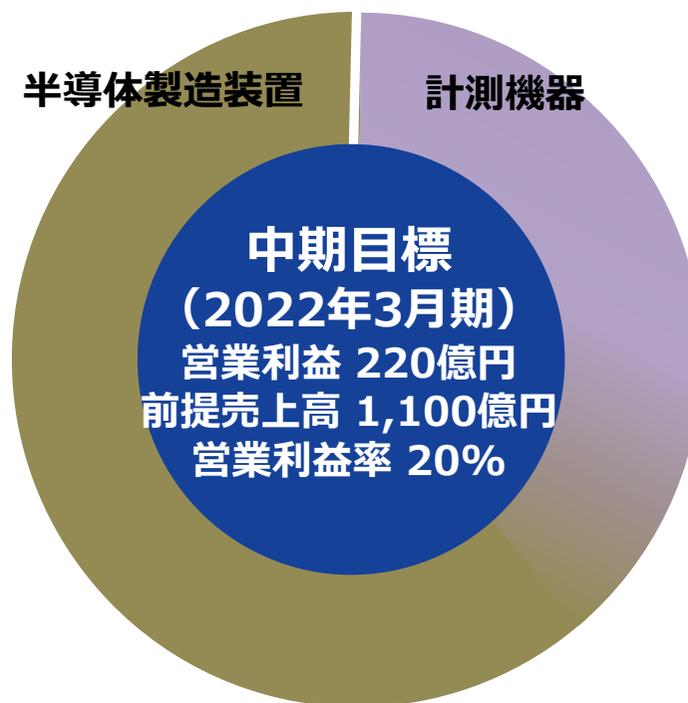
- 2020年1月稼働開始



計画通り設備投資を実施 飯能工場は2022-2024年度中期経営計画にて継続

## 半導体製造装置

- 検査装置(フローバ)の“テレポート化”戦略継続による更なる市場拡大
- ➡ 灯り専用機、高スループット機、角型基板対応など顧客目線でのラインアップ拡大
- 加工装置のアプリケーション力強化・連動したサービスビジネス並びに消耗品売上の拡大
- ➡ ガイ・グラインが共に顧客要求に応え、連動した消耗品売上増加
- 内製化促進, 新工場運用
- ➡ 内製取り組み強化、生産力大幅アップ



## 計測機器

- 電気計測 (充放電試験) 進出による対象市場拡大, シグーの最大化
- ➡ バッテリー受託測定ビジネスの獲得・機器開発の継続
- 既存製品群の差異化・国内外顧客開拓と, 連動したサービスビジネス拡大
- ➡ 既存顧客を対象にしたアフタービジネスの強化  
自動化・省力化の商談増
- 生産効率化・自動化
- ➡ 一部工程自動化  
高精度基幹部品の内製化

## 市場前提

- ◆ Society 5.0の伸張
- ◆ 半導体・電子部品の爆発的な成長
- ◆ 計測ニーズの変化



## 事業機会

- ◆ 半導体の加工精度、後工程の重要性高まり
- ◆ 脱炭素・自動化の流れ
- ◆ 計測機器の強み



## 定量目標

- ◆ ROE 15%以上
- ◆ 売上高 1,700億円
- ◆ 営業利益 375億円  
(利益率22%)



## サステナビリティ

- ◆ “夢のある未来を築く”  
一員であり続ける



世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界No.1の  
商品を創り出し、皆様と共に大きく成長していく

Growing together with partners and customers by collaborating technology,  
knowledge and information to create the world's No.1 products.

理念を示すモットー

→ 「WIN-WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」  
*WIN-WIN relationships create the World's No. 1 Products*

コーポレートブランド



→ “Accrete (共生)” と “Technology(技術)”の合成語

## 企業理念実現のための枠組み



## 当社事業構成の特徴



### 異なる2事業を有する意義

- 異なる事業領域を有する収益安定性
- 事業間シナジー  
(唯一の“計測技術”を持つSPE企業)

# 2022-2024年度 中期経営計画 市場前提



## ヘルスケア



手術ロボット, 遠隔診療

## 暮らし



スマート家電, オンライン授業

## ものづくり



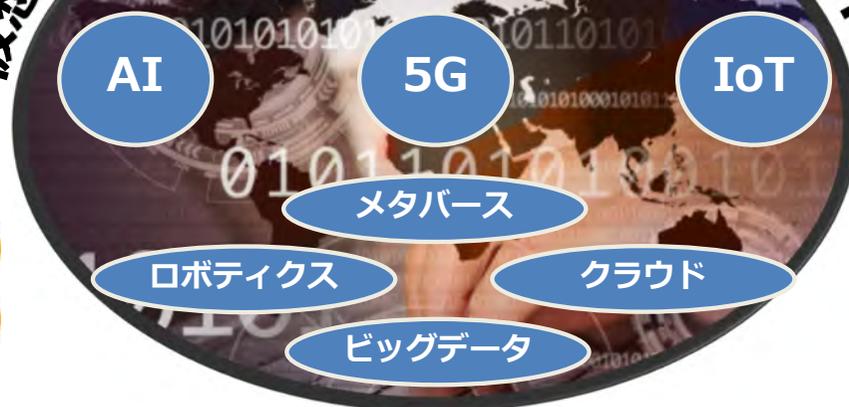
スマートファクトリー

## 自動車



EV(電気自動車), 自動運転

## 仮想空間と現実空間の融合 (Society 5.0)



## 金融



オンライン決済, 仮想通貨

## インフラストラクチャー



電子政府, イン트라ネットワーク

## ロジスティックス



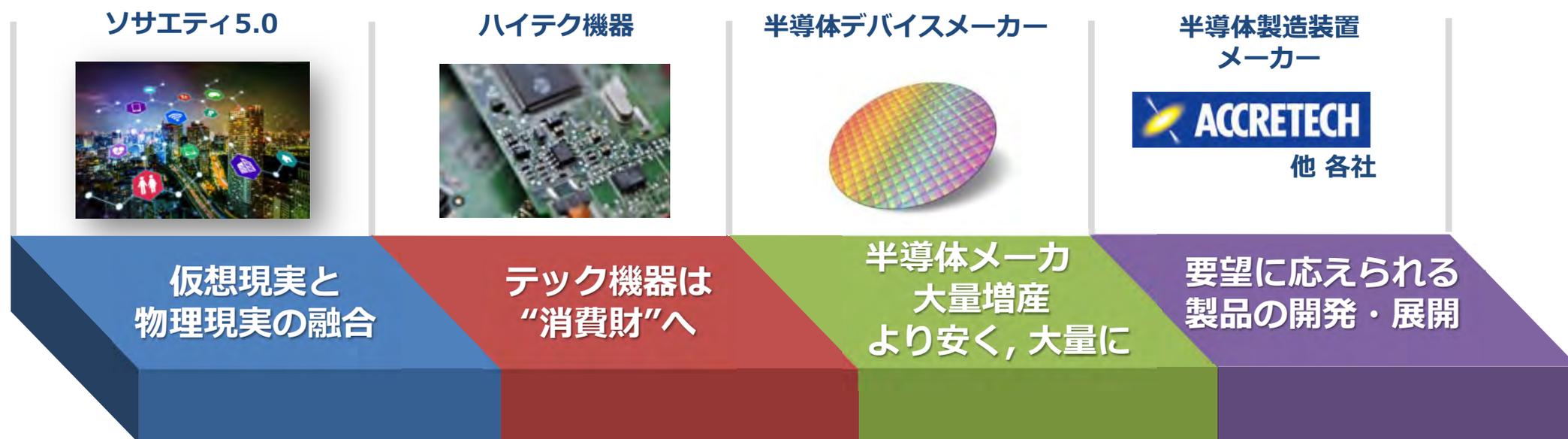
自動搬送倉庫, ドローン配達

## エネルギー生成



エコロジーと効率を両立した発電

- Society 5.0 (5Gを軸とする仮想空間・現実空間の融合)により、半導体・電子部品の 桁違いの大量生産/大量消費の時代へ
- 半導体 製造工程における後工程の重要性が高まる



# 2022-2024年度 中期経営計画 市場前提 (計測)

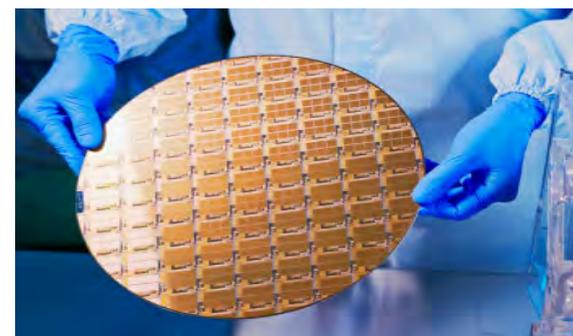
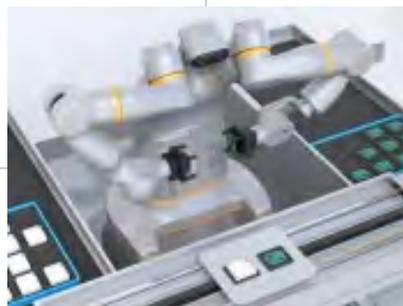


- カーボンニュートラルやデジタル化に伴い 市場は大きく変わる
- 内燃機関向け需要が減少の一方、NEV, 自動化, 半導体, 医療など 計測ニーズも大きく変化

## 自動車

## 非自動車

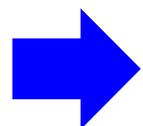
安定業界



成長業界

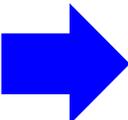


前提	当社の事業機会
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 半導体デバイスの高機能・複雑化</li> <li>➤ 信頼性が求められるデバイスの増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 検査の重要性が増す</li> <li>➤ 測定時間延伸</li> <li>➤ 測定条件の広がり</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 安定した半導体個数成長 (大量生産・大量消費)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 積層・パッケージングの進化</li> <li>➤ 加工装置の需要増加</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ カーボンニュートラルに向けた SiC/GaN パワー半導体の革新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 市場そのものの拡大</li> <li>➤ 新たな加工プロセス構築</li> <li>➤ 信頼性重視の検査</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ デバイス検査・加工精度要求の高まり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 当社計測機器とのシナジー</li> </ul>



**事業機会の拡大により、市場の伸びを上回る成長を想定**

前提	当社事業機会
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ カーボンニュートラルに向けた NEV・再エネ市場拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NEV化による素材/部品の変化</li> <li>➤ 高精度測定需要の増加</li> <li>➤ NEVなどのバッテリー測定</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 労働人口減によるものづくり自動化の流れ</li> <li>➤ 計測技術の変化 (検査室 抜き取り計測→生産ライン 全数計測)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ロボット + 測定機の組み合わせ</li> <li>➤ 高精度部品の全数測定</li> <li>➤ 測定機そのもののニーズ変化</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 非自動車分野のものづくり市場拡大 (半導体・航空機・医療など)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 半導体向け (非接触)</li> <li>➤ 航空エンジン部品 (高精度)</li> <li>➤ 人口関節/骨/医療機器 (非接触)</li> </ul>

 **ものづくりの変化により計測需要が変化  
新たな計測需要の開拓も進め、既往ピーク (2018年度)を超える水準を想定**

## ➤ 2024年度 定量目標を設定

ROE	15%以上
売上高	1,700億円 (半導体1,320億円/計測380億円)
営業利益	375億円 (営業利益率：22%)

## ➤ 全社取り組み

### 研究開発投資

先端技術、顧客ニーズ対応開発を強化

### 生産キャパシティ拡充

飯能工場稼働 (2023年度)  
SPEキャパシティ 1,400億+α  
その次の工場投資も検討

### 環境投資

2030年CO2排出量 50%削減  
(2018年度比)に向け  
必要な投資を検討

### 投資評価指標

社内評価基準にROICを検討

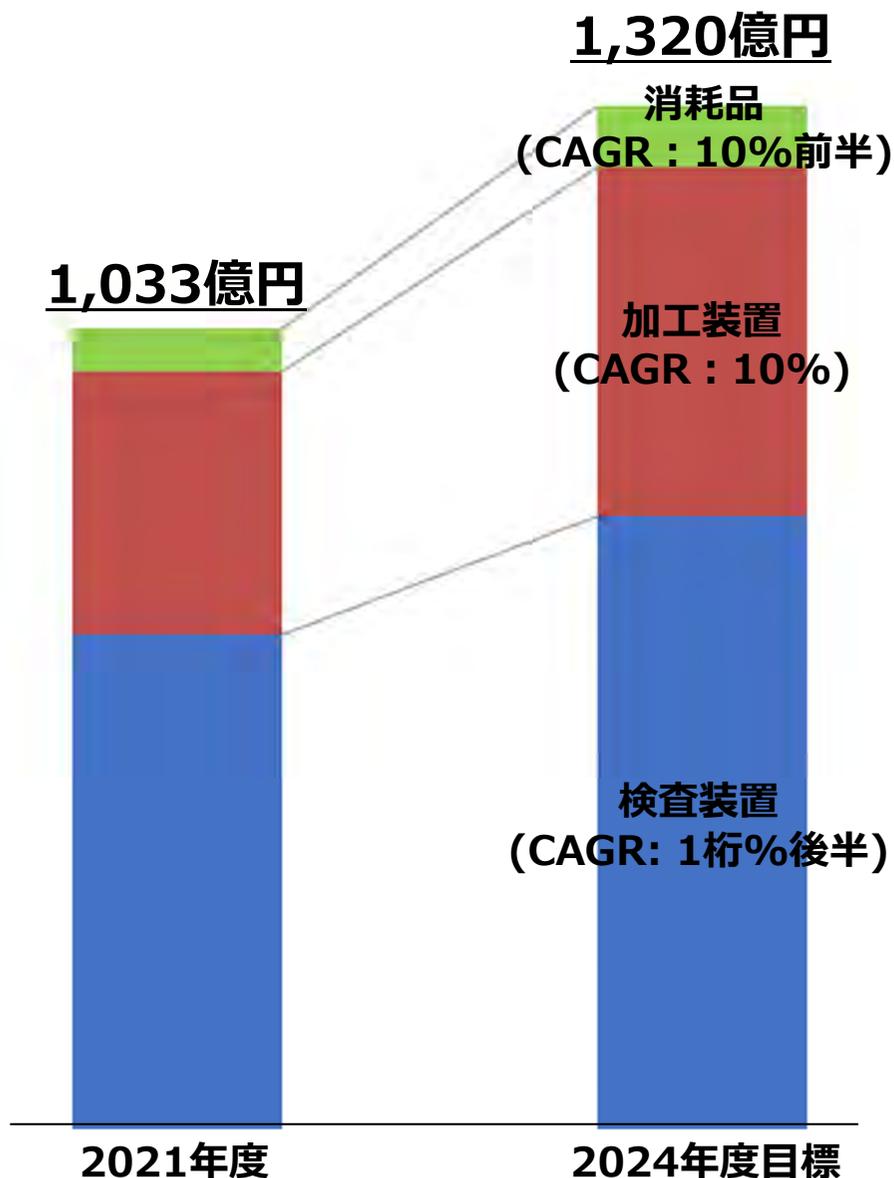
### アプリケーション強化

各国拠点におけるデモ設備強化

### サステナビリティ

取り組み強化 (後述)

## 製品別売上構成比



## 消耗品 戦略

- 顧客ニーズにマッチした開発・拡販
- グラインダ消耗品販売の強化

## 加工装置 戦略

- アブレーションダイサ市場参入
- SiC/GaN向け高剛性研削盤強化
- ウェーハ用グラインダ強化

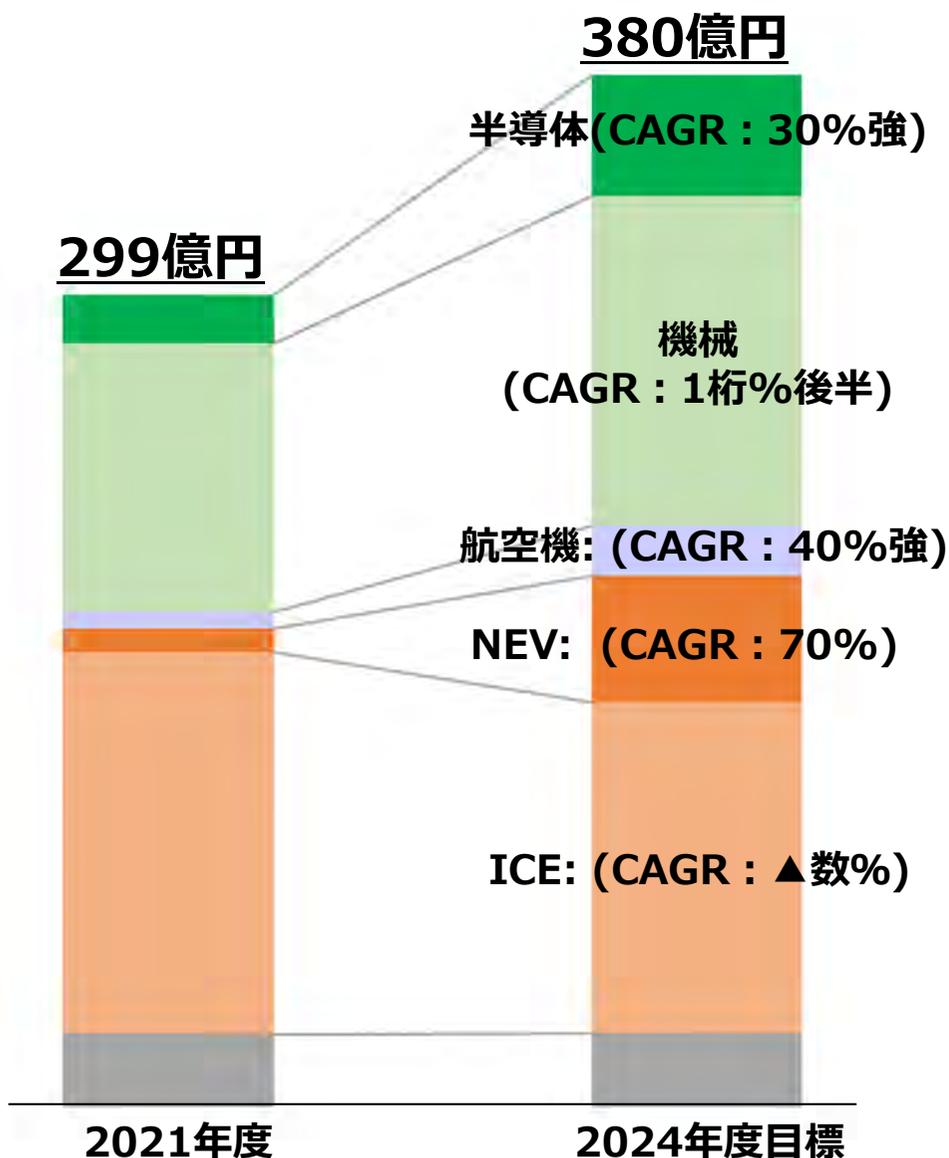


## 検査装置(プローバ) 戦略

- さらなるデパート化推進による用途拡大 (HPC、パッケージ、メモリ、パワーデバイス等)



## 用途別売上構成比



### 半導体向け 戦略

- 高精度・非接触計測機器の拡販
- 当社SPE事業とのシナジー強化

### 機械・航空機向け 戦略

- 医療: 非接触式計測機器の強化
- 航空機: 航空エンジン部品特化計測機器
- 自動化ソリューション

### NEV向け 戦略

- 充放電試験装置 受託ビジネス強化
- EVギア・モータ等 新たな測定需要獲得
- 自動化ソリューション

### ICE向け 戦略

- 産業エンジン、ハイブリッド関連 ビジネス獲得
- 既存製品 保守点検業務強化
- 自動化ソリューション

## 基本的な考え方



## 中期キャッシュアロケーション 目途

### 試験研究費

- 売上高試験研究費比率 10%以内

### 設備投資

- 通常時：EBITDA \* 25%内
- Max時：EBITDA \* 50%  
(EBITDA = 営業利益 + 減価償却費)

### 株主還元

- 配当：配当性向 40%を目安に実施
- 投資動向などを勘案し 自己株取得

### M&A等

- FCF マイナスにならないよう配慮

重要課題(マテリアリティ)		2021年度活動実績	対応するSDGs
環境	製品を通じての環境貢献 (エコプロダクツ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>製品LCAの取り組み</li> <li>欧州WFDのSCIP対応</li> <li>PFOA/TSCA/RoHS3への対応</li> </ul>	   
	事業活動を通じての環境貢献 (エコファクトリー)	<ul style="list-style-type: none"> <li>低炭素電力導入量増加(2千t/年CO2削減)</li> <li>水使用量削減と再利用</li> <li>廃棄物リサイクル率98.5%</li> </ul>	
社会	製品を通じての価値提供	<ul style="list-style-type: none"> <li>高品質・安全な製品の提供</li> </ul>	   
	持続可能なサプライチェーンの強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>サプライヤのCSR活動推進</li> <li>サプライヤWEBシステム構築によるサプライヤとの対話</li> </ul>	
	多様な人々が活躍できる職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>女性活躍推進計画に基づく女性採用の拡大</li> <li>キャリア支援活動</li> </ul>	
	働きがいのある職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業員のメンタルケアしくみづくり(人材育成力研修企画)</li> <li>有給休暇取得促進(5日取得100%)</li> </ul>	
ガバナンス	経営基盤の強化 (コンプライアンスの強化)	<ul style="list-style-type: none"> <li>コンプライアンスの強化</li> <li>情報セキュリティ強化</li> </ul>	

SCIP: 欧州化学物質庁のデータベース (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products))

WFD: 廃棄物枠組指令 (Waste Framework Directive)

当社のサステナビリティモットー

**東京精密グループは“夢のある未来”を築く  
一員であり続けます。**

人権の尊重

地域社会への参画と貢献

環境問題への取組み

人財育成

社会からの信頼確立

公平、透明で効率的なガバナンス  
体制の構築と運営

# 2022-2024年度 中期経営計画 マテリアリティと目標



2022 マテリアリティ	主な取り組み	目標	関連するSDGs
環境問題を解決する 製品・事業活動・提供した 製品・サービスによる 環境貢献	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 環境配慮型製品開発 (SCOPE 3削減、含有化学物質管理)</li> <li>➢ 温暖化防止防止(CO2排出削減、省エネ)</li> <li>➢ 廃棄物削減、資源再利用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 欧州・米国法令順守</li> <li>➢ 2030年CO2排出量 2018年度比50%減</li> <li>➢ 2%/年削減</li> </ul>	
社会課題を解決する 高付加価値製品・ サプライチェーンの構築	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ クリーンテック</li> <li>➢ 自社生産～自社検査システムによる品質改善・保証</li> <li>➢ 遠隔サポートの導入</li> <li>➢ サプライヤ協力関係構築</li> <li>➢ BCPの取り組み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ サプライヤ向けWEBツール, CSRガイドラインのリリース</li> <li>➢ アセスメントの実施と改善活動</li> </ul>	
多様な人々が活躍でき、 心身ともに健康で 働き甲斐のある 職場づくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 女性活躍推進 (採用促進、定着、育成)</li> <li>➢ 主体的に学べる機会提供</li> <li>➢ 健康経営 (2035年目標)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 従業員 女性採用比率 20%、女性従業員比率 10% (正社員ベース)</li> </ul>	
企業活動を支える経営基盤・ コンプライアンス・ リスクマネジメントの強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ コンプライアンス強化</li> <li>➢ 情報セキュリティ強化</li> <li>➢ 事業継続計画強化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ グループ会社 マネジメントシステム構築</li> <li>➢ 情報資産価値の向上</li> <li>➢ 事業継続蓋然性の向上</li> </ul>	
人権の尊重	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 人権尊重意識の高揚</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 人権方針の制定</li> <li>➢ 人権デューディリジェンスの検討</li> </ul>	

## 次第

I. 2021年度 業績説明, 2022年度業績予想

～質疑応答～

II. 2022-2024年度 中期経営計画

～質疑応答～



サステナビリティ情報：



<https://www.accretech.jp/sustainability/index.html>

IR情報：



<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>

# 補足資料

# 損益計算書



(百万円)	会計期間				四半期							
	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2021年3月期				2022年3月期			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	101,520	87,927	97,105	133,277	21,070	24,041	21,597	30,395	28,937	32,526	31,981	39,831
売上原価	60,430	53,452	60,190	79,772	12,863	15,433	13,504	18,389	17,484	19,273	19,828	23,186
売上総利益	41,090	34,474	36,914	53,504	8,207	8,608	8,093	12,005	11,453	13,253	12,153	16,645
販売費および一般管理費	20,869	22,192	21,351	24,954	5,030	5,502	5,057	5,760	5,457	6,320	5,828	7,347
営業利益	20,221	12,282	15,562	28,550	3,176	3,105	3,035	6,245	5,995	6,932	6,324	9,298
営業外収益	688	255	540	994	194	118	106	214	135	66	270	616
営業外費用	104	177	235	154	25	153	205	-55	110	27	17	93
経常利益	20,805	12,360	15,867	29,390	3,345	3,070	2,936	6,515	6,019	6,971	6,577	9,821
特別利益	58	57	1,354	390	6	-	149	1,198	13	-	-	377
特別損失	419	1,712	1,074	34	-	293	108	672	-	-	-	34
税引前利益	20,443	10,705	16,147	29,746	3,351	2,776	2,977	7,041	6,033	6,971	6,577	10,164
法人税等合計	5,719	3,598	3,978	8,247	886	573	712	1,806	1,664	1,702	1,780	3,099
親会社株主に帰属する 当期純利益	14,665	7,156	12,175	21,441	2,470	2,207	2,264	5,232	4,352	5,255	4,776	7,057
1株当たり当期純利益 (円)	352.92	171.89	293.83	525.34	59.30	52.98	54.73	127.55	105.98	128.42	117.57	173.65
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	350.23	170.72	291.43	520.30	-	-	-	-	-	-	-	-

# セグメント別業績推移



(百万円)		会計期間				四半期							
		2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2021年3月期				2022年3月期			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注高	半導体	65,335	57,709	93,181	157,407	12,903	15,932	28,683	35,662	33,853	38,596	46,665	38,292
	計測	33,573	29,866	23,878	33,667	5,754	5,022	6,420	6,681	7,858	8,184	10,051	7,573
	合計	98,909	87,576	117,060	191,074	18,657	20,955	35,103	42,344	41,711	46,781	56,716	45,865
受注残高	半導体	27,670	29,182	50,619	104,666	26,653	24,610	38,188	50,619	61,676	75,375	97,334	104,666
	計測	9,165	7,782	6,301	10,051	7,898	6,855	6,783	6,301	8,018	8,573	11,350	10,051
	合計	36,836	36,965	56,920	114,717	34,552	31,465	44,971	56,920	69,694	83,949	108,684	114,717
売上高	半導体	69,117	56,198	71,745	103,360	15,432	17,975	15,106	23,231	22,796	24,897	24,707	30,959
	計測	32,403	31,728	25,359	29,917	5,638	6,066	6,491	7,163	6,141	7,629	7,274	8,872
	合計	101,520	87,927	97,105	133,277	21,070	24,041	21,597	30,395	28,937	32,526	31,981	39,831
営業利益	半導体	13,195	7,915	13,565	24,893	2,832	2,850	2,525	5,358	5,328	5,967	5,334	8,264
	計測	7,025	4,366	1,996	3,657	344	255	510	886	666	965	991	1,033
	合計	20,221	12,282	15,562	28,550	3,176	3,105	3,035	6,245	5,995	6,932	6,325	9,298
営業利益率	半導体	19.1%	14.1%	18.9%	24.1%	18.4%	15.9%	16.7%	23.1%	23.4%	24.0%	21.6%	26.7%
	計測	21.7%	13.8%	7.9%	12.2%	6.1%	4.2%	7.9%	12.4%	10.9%	12.7%	13.6%	11.7%
	合計	19.9%	14.0%	16.0%	21.4%	15.1%	12.9%	14.1%	20.5%	20.7%	21.3%	19.8%	23.3%

# 貸借対照表



(百万円)		2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
流動資産	現金及び預金	41,518	34,640	43,657	49,033
	売上債権※1	36,146	29,633	30,946	38,367
	在庫	29,995	30,152	32,886	40,281
	その他	2,434	3,345	4,025	6,103
	合計	110,094	97,771	111,516	133,785
固定資産合計		47,478	48,777	50,039	56,403
総資産		157,573	146,549	161,556	190,188
流動負債	買入債務※2	26,328	16,895	23,062	29,876
	その他	14,620	12,121	16,233	25,765
	合計	40,948	29,017	39,296	55,641
固定負債合計		9,220	7,857	5,482	3,561
負債合計		50,169	36,874	44,778	59,202
純資産合計		107,403	109,674	116,777	130,986
負債・純資産合計		157,573	146,549	161,556	190,188
有利子負債合計		11,415	9,641	7,581	5,494
自己資本比率		67.3%	73.9%	71.4%	68.1%
自己資本利益率(ROE)		14.4%	6.7%	10.9%	17.5%

※1: 電子記録債権、契約資産を含む

※2: 電子記録債務を含む

# 各種費用, キャッシュフロー



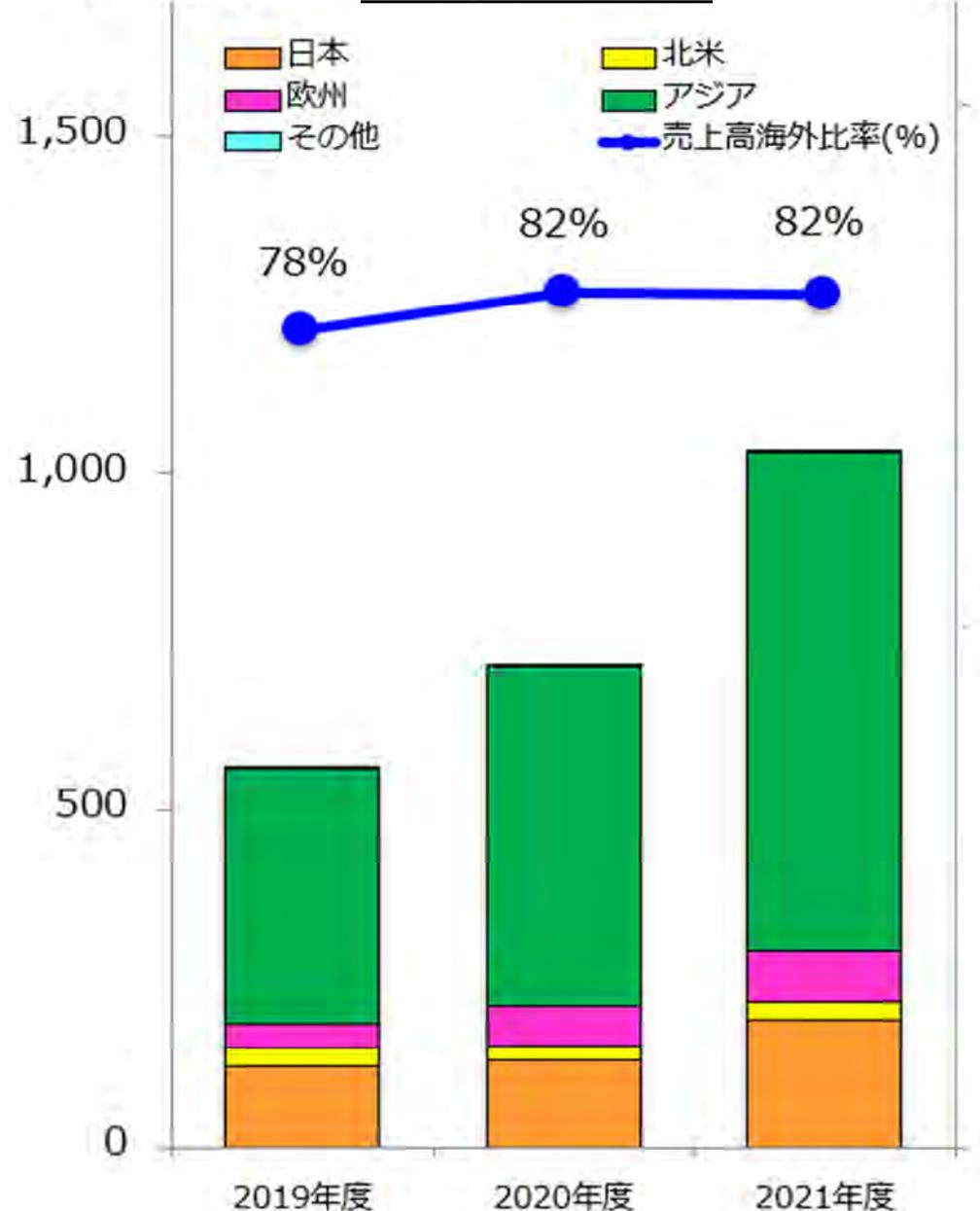
(百万円)	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
試験研究費	7,469	8,234	7,193	8,146
設備投資	13,872	7,477	5,950	9,816
減価償却費(のれん除く)	2,655	3,450	3,516	3,574

(百万円)	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期
営業活動によるキャッシュフロー	12,932	5,965	22,062	24,062
投資活動によるキャッシュフロー	-13,952	-6,116	-5,191	-9,036
フリーキャッシュフロー	-1,020	-150	16,871	15,026
財務活動によるキャッシュフロー	5,443	-6,375	-8,282	-10,350
現金及び現金同等物に係る 換算差額等	-223	-159	429	706
現金及び現金同等物の期末残高	41,290	34,605	43,624	49,006

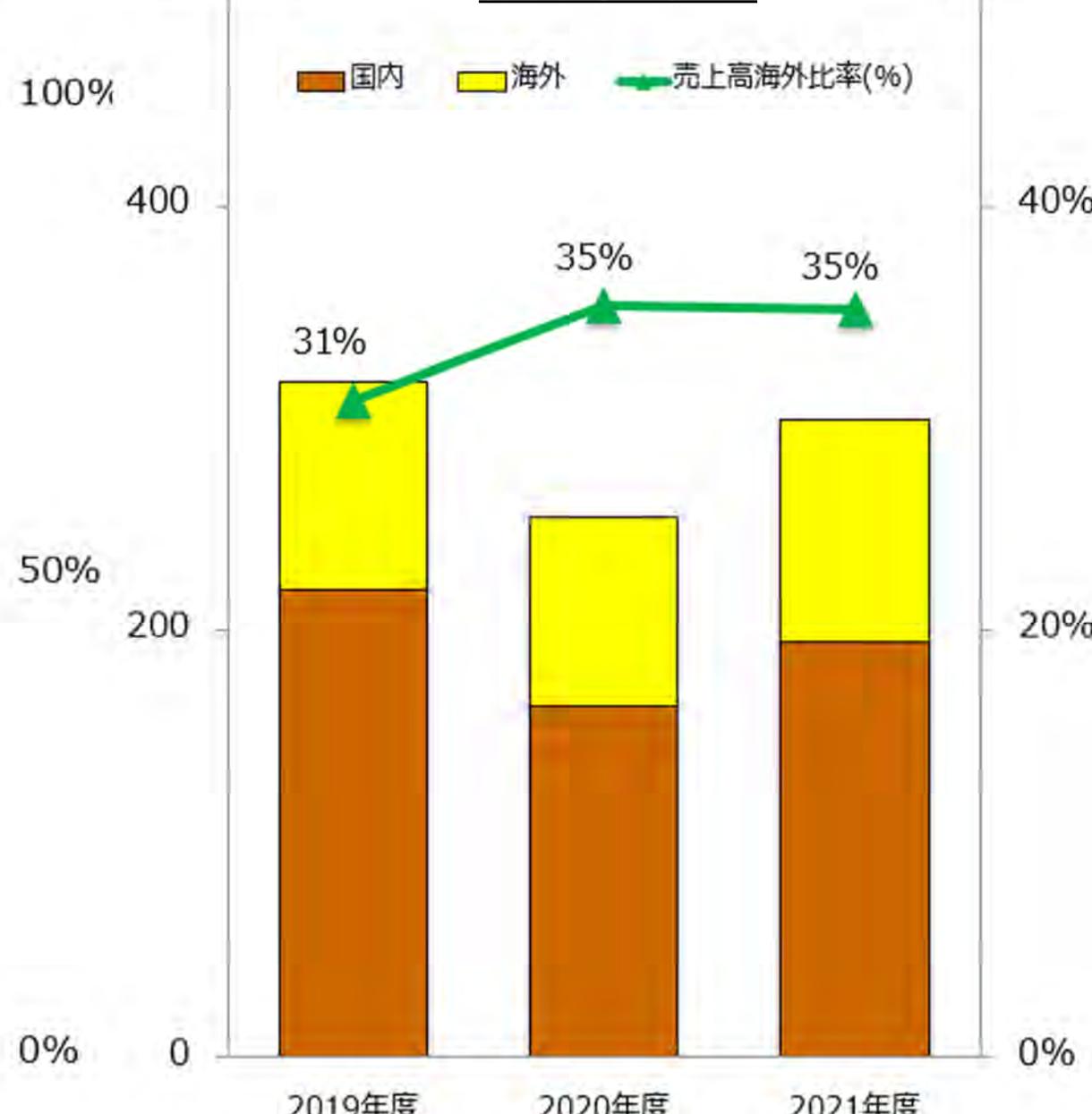
# 地域別売上高



売上高(億円) **半導体製造装置** (%)



売上高(億円) **精密計測機器** (%)



# 従業員数推移



従業員数(人)

連結子会社数



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算